

各 位

2026年6月26日

会 社 名 宮越ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 宮 越 邦 正  
(コード番号 6620 東証プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員 高木 昭彦  
(TEL : 03 - 3298 - 7111)

## 投資家の皆さまへ — 不動産と半導体の二本立てへ —

当社は、2035年度に「時価総額1兆円企業の実現」を長期ビジョンとして掲げております。そのマイルストーンとして、2026年5月13日に「MIYAKOSHI Vision 2030」を発表し、2030年度に時価総額3,000億円、イノベーション事業による営業利益100億円の達成を目標としております。今回ご報告する半導体・ロボティクス新規事業は、この中期計画を支える中核施策です。

### ▶ 当社の強み:中国14省4直轄市ネットワーク

当社グループの最大の強みは、ワールド・イノベーション・センター(WIC)への企業誘致を通じて構築してきた「14省4直轄市」における政府および現地有力企業との関係にあります。

これらの地域は中国GDPの80%超を占めており、当社グループの競争優位の源泉となっています。

### ▶ 中国半導体メーカーの調達先としての開拓

当社グループには、中国の有力ハイテク企業から日本市場参入に向けた支援要請が寄せられており、14省4直轄市政府の応援を得ながら、中国半導体メーカーの上位10社(約7兆円規模)を対象とした調達先開拓と提携を進めています。

現在、提携を進めている主要メーカーは、メモリー分野を牽引するYMTC社(NAND)およびCXMT社(DRAM)の2社です。両社が属するメモリー市場は約5~6兆円規模に達しており、日本企業にとって重要な調達先となり得る存在です。

## ➤ 日本における商流構築

日本側では、半導体商社との業務提携を進めており、2027年3月までに大手上場10社(約5兆円規模)との連携強化を目指しています。

これらの取り組みにより、日中双方で主要市場の半分をカバーする商流ネットワークの形成を進めています。

## ➤ 推進体制:日中一体の実行力と効率性

推進体制については、日中双方で半導体・ロボティクス分野に精通した業界一流人材を採用済みです。さらに、中国の大手メーカーと日本の大手商社を、少数精鋭のチームが取りまとめることで、経費を抑えながら高い実行力を発揮するビジネスモデルを構築しています。

また、中国メーカーの工場から日本企業まで、調達・検品・輸送・納品を一貫して担う物流体制を整備しています。

## ➤ WIC TOKYO:日中技術連携のハブへ

当社は、日中の先端技術をつなぐ産業連携拠点として「WIC TOKYO」の設立を構想しています。羽田空港周辺など先端企業が集まる都内エリアを候補とし、中国の大手メーカーに加え、当社と日本市場の総代理店契約等を結ぶ優れた技術を持つ将来のユニコーン候補企業に対し、展示ブースを無償提供します。

スタッフを派遣しない企業については、当社の専任スタッフが技術および商談を代行します。すべての契約は当社を介する形とし、技術・企業・市場をつなぐ新しい産業連携モデルを構築していきます。

## ➤ 不動産×半導体の二本立てで、2030年・2035年の成長へ

当社グループは、不動産事業で培った基盤を活かしつつ、半導体・ロボティクス領域を新たな成長エンジンとして育成し、2030年、そして2035年に向けた持続的な企業価値向上を実現してまいります。

本件に伴う2027年3月期の連結業績予想の修正につきましては、「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」として、別途お知らせいたします。

以上